

115 年「以 AI 輔助為核心之 SOLIDWORKS 半導體散熱設計與熱流分析實務」

課程日期：115 年 8 月 26(三) ~ 28(五)共三天

課程地點：國立臺北科技大學綜合科館電機系 511 教室(臺北市大安區忠孝東路三段 1 號) 課程內容：

日期	時間	課程名稱/課程內容	授課教師
8/26 (三)	08:45~09:00	報 到	
	SOLIDWORKS Design 零件與組合併設計		
	09:00~10:00	SOLIDWORKS 安裝、檔案結構與操作介面	SOLIDWORKS Design 李朋育 工程師
	10:00~11:00	2D 草圖與 3D 模型基本特徵	
	11:00~12:00	進階特徵操作(板金、曲面)	
	12:00~13:00	午 餐	
	13:00~14:00	零件裝配條件與爆炸視圖	SOLIDWORKS Design 李朋育 工程師
	14:00~15:00	組合併特徵	
	15:00~16:00	量測工具(含剖面切割與干涉檢查)	
	16:00~17:00	工程圖基本操作	
	17:00~18:00	綜 合 討 論	
8/27 (四)	08:45~09:00	報 到	
	SOLIDWORKS Thermal 熱傳導與 Flow 計算流體分析		
	09:00~12:00	有限體積法基礎理論	FLOW Simulation CAE 林宜正 應用工程師
		軟體操作介面介紹	
		練習一 球閥 (模型準備、內部流場分析、設計變更)	
		練習二 LED 燈泡 (外部熱流分析、自然對流及輻射)	
		練習三 電子冷卻 (內部熱流分析、外部熱流分析、工程資料庫的建立)	
	12:00~13:00	午 餐	
	13:00~14:00	練習四 瞬態熱傳遞(暫態分析)	FLOW Simulation CAE 林宜正 應用工程師
	14:00~15:00	練習五 氣液共存系統	
	15:00~16:00	補充一 旋轉體(旋轉體)	
	16:00~17:00	補充二 自由液面(自由液面)	
	17:00~18:00	綜 合 討 論	
8/28 (五)	08:45~09:00	報 到	
	Flow Simulation Electronic Cooling Module		
	09:00~10:00	ECM-焦耳熱	FLOW Simulation CAE 林宜正 應用工程師
	10:00~11:00	ECM-進階電子冷卻	
	11:00~12:00	補充三 FEA 壓力傳遞	
	12:00~13:00	午 餐	
	SOLIDWORKS Composer 與 SOLIDWORKS Aura AI 工具介紹		
	13:00~14:00	Aura 與 SOLIDWORKS AI 應用	SOLIDWORKS Design

	14:00~15:00	新手也能做動畫	李朋育 工程師
	15:00~16:00	靈活的互動式 BOM 表	
	16:00~17:00	互動式檔案與應用說明	
	17:00~18:00	綜 合 討 論	